

產品技術說明

補口型號：S-530

適用成色：	18K (低焊)	色 澤：	黃色
含鎳成份：	0 %	含銀成份：	33.2 %
含鈮成份：	0 %	含鉑成份：	0 %
應 用：	製作 18K 黃金低溫焊料		
優 點：	易用、流動性高、少砂孔		

建議使用參數：

建議入金量：75.0%

合金熔解溫度：18K / 752 °C

技術補充：

1. 注意合金熔溫會隨黃金/補口比例而改變。
2. 不應循環再用舊物料作焊接之用。
3. 焊接時需加入適量熔劑。
4. 鑄件設計必須適合焊接。
5. 以下是兩種普遍採用的焊接方法：
 - a. 加熱前先在接口上放置少量焊料，然後在接口地方加熱至合適溫度，讓焊料流進接口內。
 - b. 把加了熔劑的接口加熱至合適溫度，然後放入焊料，讓它接觸接口而熔解

備註：以上資料和溫度祇供參考之用，實際需視個別情況調校。若有任何疑問，歡迎致電查詢。

Main Office:
Heraeus Ltd.
 Heraeus Technology Centre
 30 On Chuen Street, On Lok Tsuen
 Fanling, N.T., Hong Kong
 Tel : (852) 2675 1200
 Fax: (852) 2682 3220

總公司:
賀利氏有限公司
 香港新界粉嶺安樂村
 安全街 30 號
 賀利氏科技中心
 電話：(852) 2675 1200
 傳真：(852) 2682 3200

Hunghom Sales Office:
Heraeus Ltd.
 Rm. 2111-13 Peninsula Square
 18 Sung On Street, Hunghom
 Kowloon, Hong Kong
 Tel : (852) 2159 5960
 Fax: (852) 2773 1090

紅磡營業部:
賀利氏有限公司
 香港九龍紅磡
 崇安街 18 號
 半島廣場 2111-13 室
 電話：(852) 2159 5960
 傳真：(852) 2773 1090